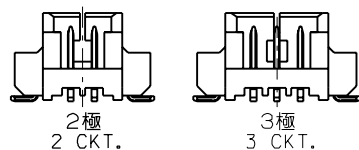
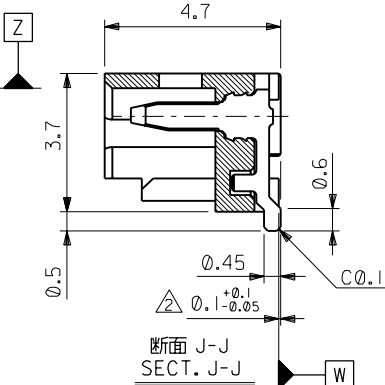


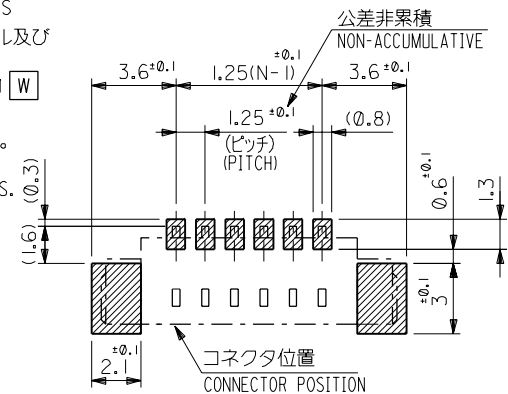
注記 NOTES

1. 嵌合相手: 51021 シリーズ MATE WITH: 51021 SERIES
水平面上においての、ウェハー底面 [W] とソルダーテール及び
フィッティングネイル底面とのズレ量を示す。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL & FITTING NAIL FROM [W]
△ 偶数極にのみ適用。APPLY EVEN CIRCUIT PRODUCTS.
△ ロック窓は、2、3極は1ヶ所、4極以上は2ヶ所とする。
LOCKING WINDOW: ONE PLACE FOR 2&3 CKTS.
TWO PLACES FOR MORE THAN 4 CKTS.

回路番号 1
CIRCUIT NO. 1

△ ロック形状図

LOCK CONFIGURATION



23.9	23.5	20.5	18.6	19.3	17.5	53398-1510	15
22.65	22.25	19.25	17.35	18.05	16.25	-1410	14
21.4	21	18	16.1	16.8	15	-1310	13
20.15	19.75	16.75	14.85	15.55	13.75	-1210	12
18.9	18.5	15.5	13.6	14.3	12.5	-1110	11
17.65	17.25	14.25	12.35	13.05	11.25	-1010	10
16.4	16	13	11.1	11.8	10	-0910	9
15.15	14.75	11.75	9.85	10.55	8.75	-0810	8
13.9	13.5	10.5	8.6	9.3	7.5	-0710	7
12.65	12.25	9.25	7.35	8.05	6.25	-0610	6
11.4	11	8	6.1	6.8	5	-0510	5
10.15	9.75	6.75	4.85	5.55	3.75	-0410	4
8.9	8.5	5.5	3.6	4.3	2.5	-0310	3
7.65	7.25	4.25	2.35	3.05	1.25	53398-0210	2
F	E	D	C	B	A	ENG. NO.	極数 NO. OF CKTS.

F	変更 REVISED	WC2000-0636	K.K.	00/3/30	材料 MATERIAL	図中参照 SEE DRAWING
E	変更 REVISED	WC800-08	H.J.	97/7/5	仕上げ FINISH	—
D	変更 REVISED	U31030	H.H.	93/10/13	適用電線範囲 WIRE RANGE	—
C	変更 REVISED	U30753	K.T.	93/7/29	被覆外径 INS. RANGE	—
B	変更 REVISED	U30610	K.T.	93/6/18	DRAWN BY '92/10/12	CHK'D BY '00/3/30
A	変更 REVISED	U30230	K.T.	93/3/10	K.T.OJO	T.YAMAGUCHI
0	新規作成 RELEASED	U20942	K.T.	92/10/12	APP'D BY '00/3/30	M.FUKUSHIMA
角 度	ANGLE	±3°	DR.	日付 DATE	尺 度 SCALE	—
30 以上 OVER	±0.3		CHK.			
10 以上 30 未満 OVER	±0.25					
10 未満 UNDER	±0.2					
角 度	ANGLE	±3°	DR.	日付 DATE	尺 度 SCALE	—
30 以上 OVER	±0.3		CHK.			
10 以上 30 未満 OVER	±0.25					
10 未満 UNDER	±0.2					

記号
LTR変更内容
REVISION RECORD

DR.

CHK.

日付
DATE尺 度
SCALE

—

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

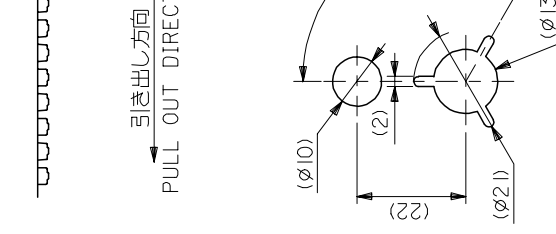
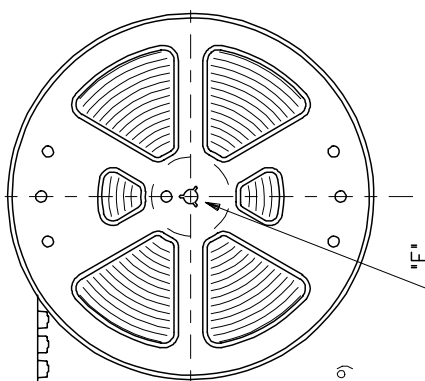
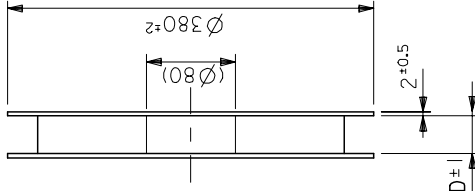
1.25 WIRE TO BOARD CONN.
WAFER ASS'Y FOR SMT (ST.)

DWG. NO.

SD-53398-**-10

REV

F

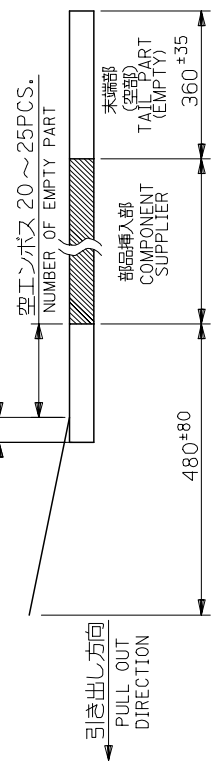


NOTES

1. 梱包数量: 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTOR: 1000PCS/REEL

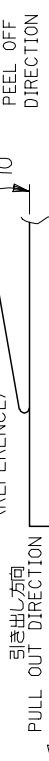
2. リードテープ長さ
LEAD TAPE LENGTH

トップテープ未接着部
TOP TAPE
NON-BONDED PART
25±10



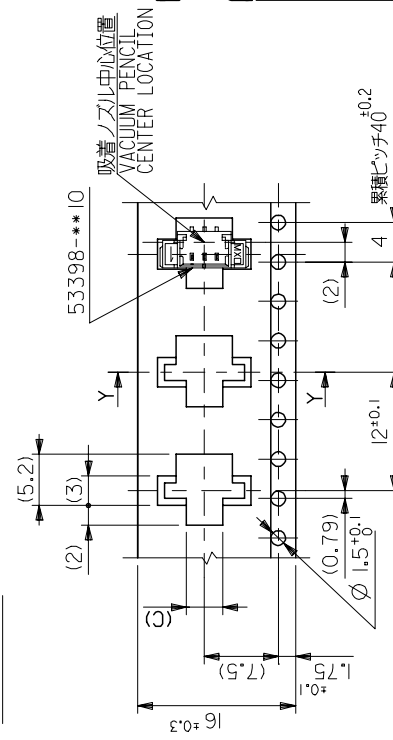
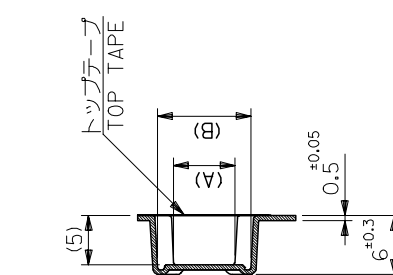
3. トップテープの剥離強度: 0.6±0.35N(60±35gf) (剥離方向は下図参照)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE: 0.6±0.35N(60±35gf)
(PEELING DIRECTION IS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)

<剥離速度: 300mm/min (参考) >
PEELING SPEED: 300mm/min (REFERENCE)



4. 53398-***10 の詳細寸法については図面 SD-53398-***10 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSIONS, SEE SD-53398-***10.

5. 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE): ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOP TAPE): PET, PE, PEF
リール (REEL): ポリスチレン (PS) <リサイクル材含む>
POLYSTYREN(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>



累積ピッチ 40±0.2
ACCUMULATIVE PITCH 40±0.2

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

SECT: Y-Y

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION
10 UNDER ±0.2	---	METRIC	◎
10 OVER 30 UNDER ±0.25			
30 OVER ±0.3			
ANGULAR ±3 °			
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS			

16 幅テープ
(TAPE WIDTH: 16)

DRAWN BY	DATE	TITLE
K. TOJO	'93/04/13	1.25 W/B CONN. WAFER ASS'Y FOR SMT.
CHECKED BY	DATE	
YAMAGUCHI	'00/12/08	EMBOSSD TAPE PACKAGE
APPROVED BY	DATE	
FUKUSHIM	'00/12/08	MOLEX INCORPORATED
MATERIAL NO.	DOCUMENT NO.	SHEET NO.
	SD-53398-***90	1 OF 3

REVISION	DESCRIPTION	REV
REVISED	EC NO. 2004/107/27	F
DRW: YAMAGUCHI	2004/107/28	
CHKD: K. ASAKAWA	2004/107/28	
APP: S. ICHIKAWA	2004/107/28	

